

# IBM dévoile une nouvelle technique de fabrication

Par *admin*

Créé le 23/11/2002 - 00:00

## IBM dévoile une nouvelle technique de fabrication

Vendredi, 22/11/2002 - 23:00 [0 commentaire](#)

- [Diminuer la police](#)
- [Augmenter la police](#)
- [Imprimer](#)
- [Version PDF](#)

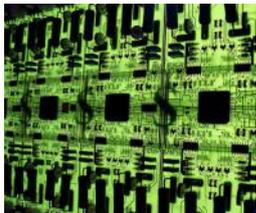
•

- [Tweeter](#)

•

•

0 avis :



[zoom](#)

Les chercheurs d'IBM profitent de l'International Electron Device à San Francisco pour dévoiler une nouvelle technique de fabrication des circuits intégrés. Celle-ci consiste à transférer une couche gravée et polie du circuit sur un substrat en verre, avant de la transférer à son tour sur un support. Permettant l'interconnexion des couches assemblées via des milliers de points, cette technique va entraîner une hausse considérable de la vitesse de communication avec les puces. Les chercheurs d'IBM ont été capables d'implémenter cette technique avec une puce d'une épaisseur d'un demi micron. Les puces actuelles les plus fines ont une épaisseur d'un dixième de micron.

NYT 10/11/02 : <http://www.nytimes.com/2002/11/11/technology/11CHIP.html>

**Noter cet article :**

**Recommander cet article :**

- 
- [Tweeter](#)
- 
  
- **Nombre de consultations** : 85
- **Publié dans** : [Electronique](#)
- **Partager** :
  - [Facebook](#)
  - [Viadeo](#)
  - [Twitter](#)
  - [Wikio](#)

[Electronique](#)

---

**URL source:** <https://www.rtflash.fr/ibm-devoile-nouvelle-technique-fabrication/article>